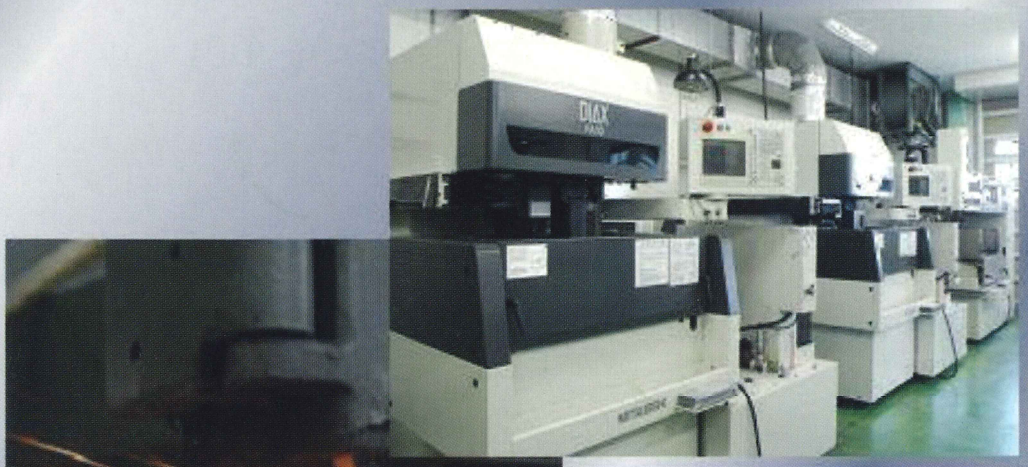
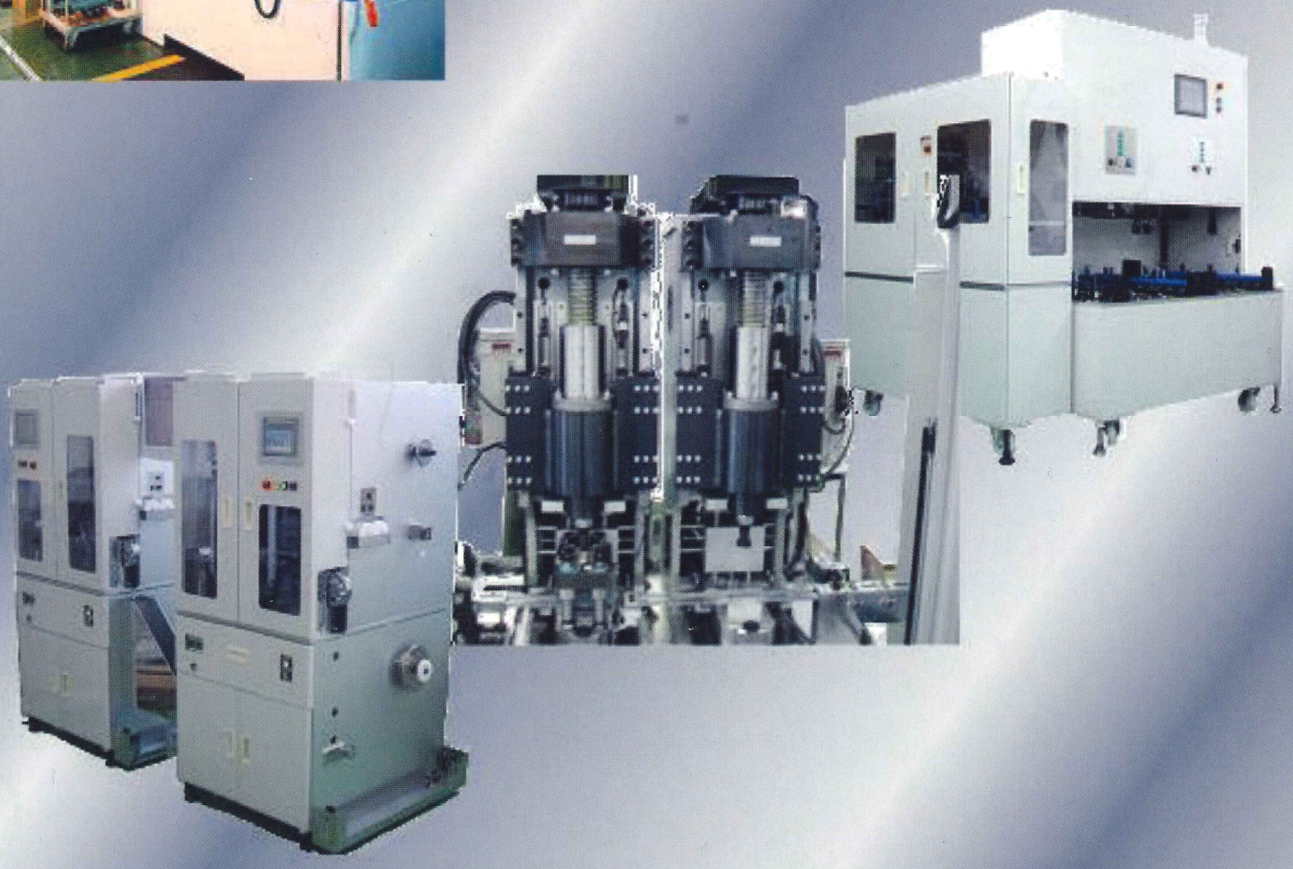
SYSTEM SEIKO







Corporate Profile
会社案内



システムセイコー株式会社

・経営理念

お客様の一躍を担い、
未来を見据えた技術革新を成し遂げ
「夢」を乗せた製品を提供し、
社会に貢献します。

ISO9001 取得による品質体制の確立

品質優先のより高い検査体制を確立

精密三次元測定器による高い信頼性

独立体制による妥協無き品質

全品検査体制の品質保証



ISO14001 取得による環境体制の確立

環境に配慮したものづくりを目指します。

事業活動のあらゆる面で環境負荷の削減

継続的な環境保全活動

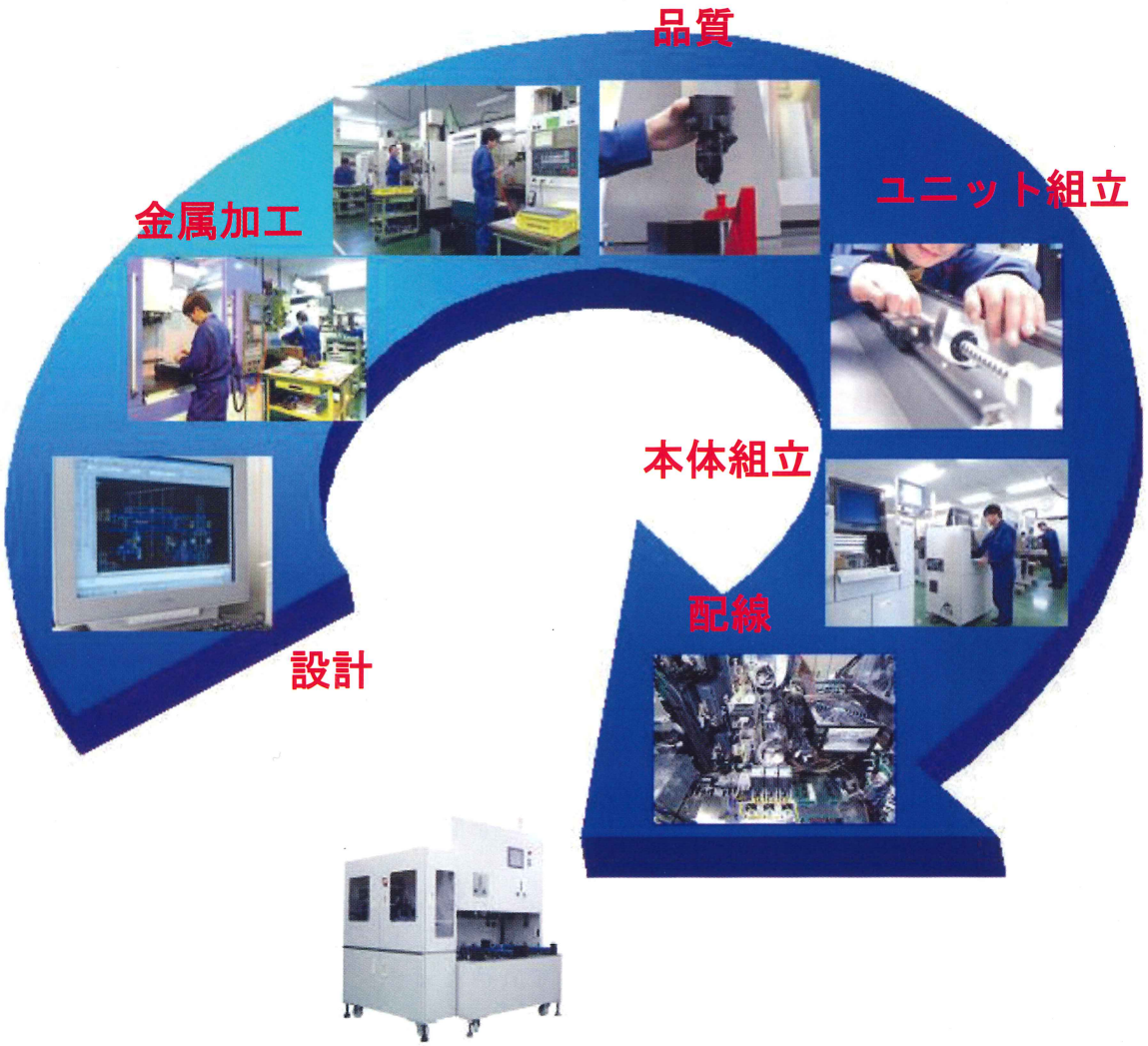
環境に対する社会的責任の推進



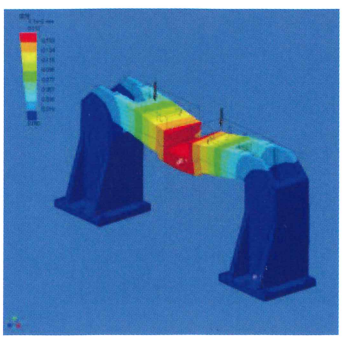
・営業品目　概要

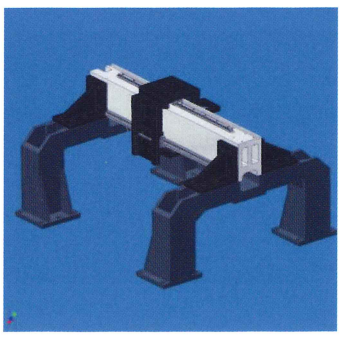
半導体製造装置をはじめ、精密機械、精密金型にいたるまで
システムセイコーが生み出す製品は、実に多岐にわたります。

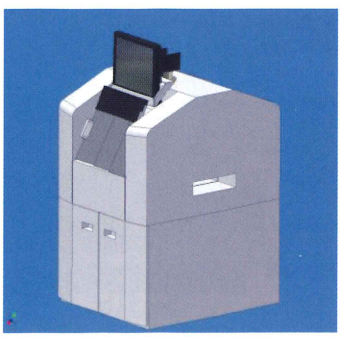
製造装置や検査装置など、自動化装置の設計製作や開発など、
お客様と一体になり提案から立ち上げまで、
責任を持った装置製造を手がけております。



半導体製造装置をはじめ、省力機械、精密加工部品の「設計・製作」に
到るまで、「技術のシステムセイコー」として、製造工程における
細かな管理はもとより、製品の全品検査、精密三次元測定による
厳格なチェック体制など、信頼性の高い品質に努めています。







・営業品目　概要

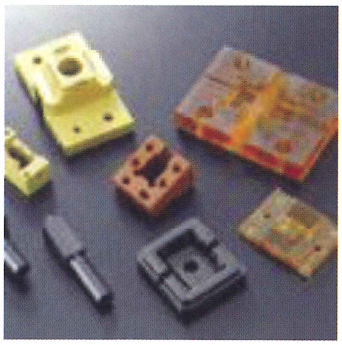
特殊材料や特殊処理などの、さまざまな加工部品から
高精度部品や難易度の高い加工部品など
お客様のニーズに対応した商品をご提供しております 。



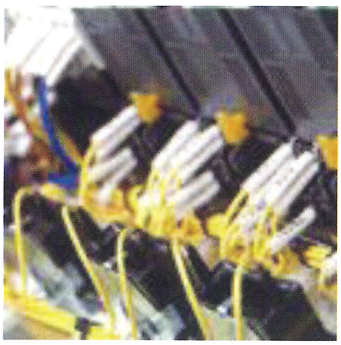
・半導体製造装置
・検査装置
・精密金型
・各種省力装置



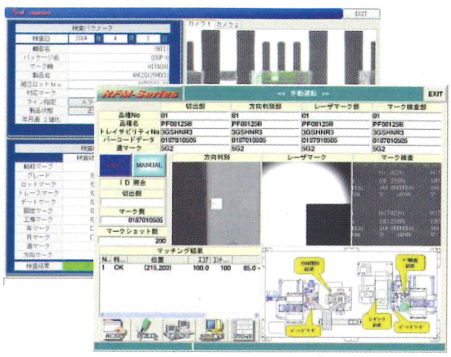
・はんだ印刷検査装置
・小型ＩＣテスターハンドラ装置



・精密機械部品
・各種金型部品
・各種消耗部品
・特殊材質、特殊処理部品



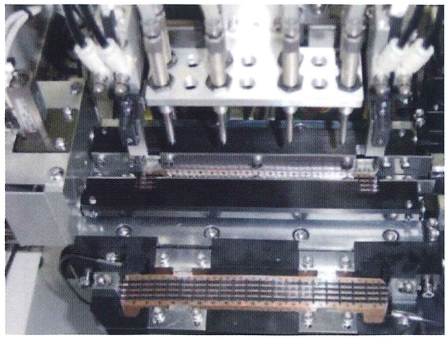
・制御配線
・基板、ハーネス製造



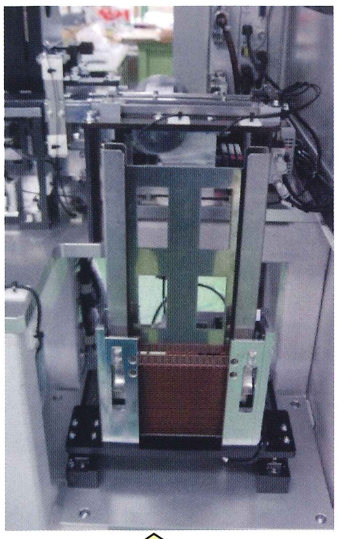
・各種制御ソフト

・営業品目　概要

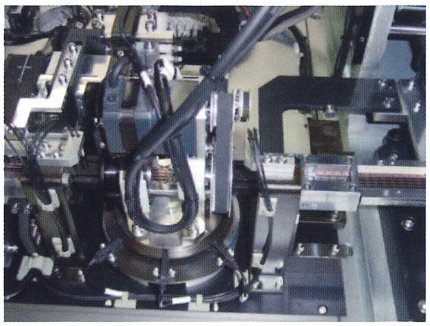
企画段階よりお客様のニーズに応じた装置を設計・製作致します。

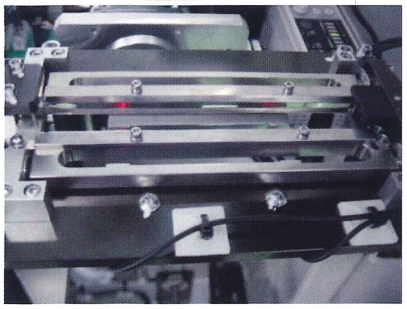


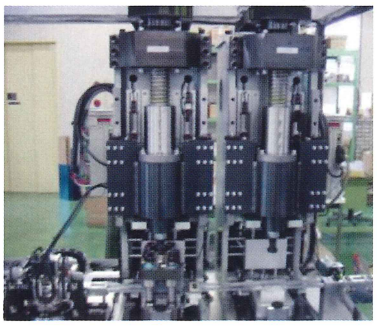


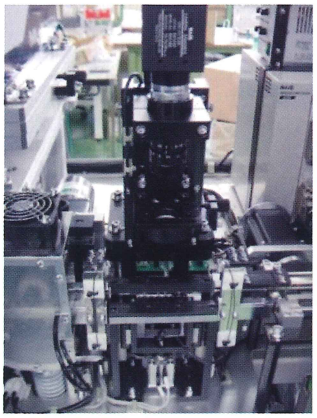


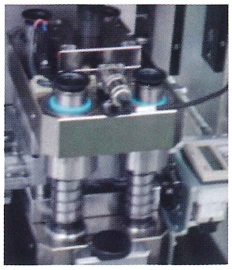
モールドレーザバリ取り装置











機能説明

・ローダ（製品供給）

フレーム収納ラックに収納されている
短冊フレームをハンドにてピックアップ
しシュートに搬送します。

・表裏判別

表裏方向判別を行い、一定の向きに
置き換えます。

・ゲートカット

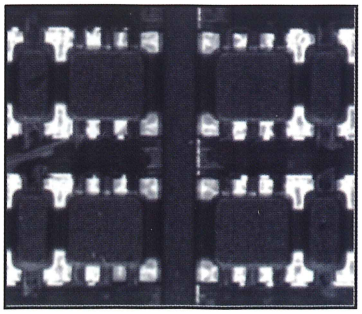
サーボプレス機構を採用し、製品に
ダメージを与えずゲートを切断します。

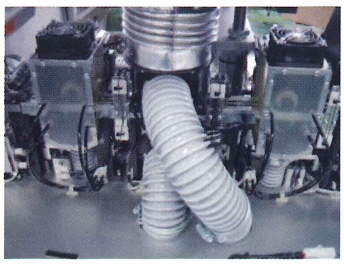
・レーザバリ取り

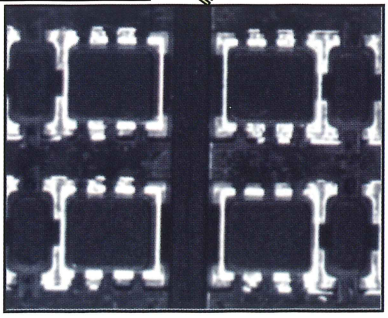
レーザを使い、半導体の外周に存在する
余分なモールドを除去します。

・アンローダ（製品収納）

フレームをフレーム収納ラックに
収納します。





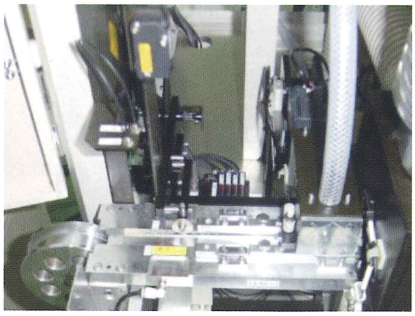


バリ取り前

バリ取り後

・営業品目　概要

企画段階よりお客様のニーズに応じた装置を設計・製作致します。







レーザマーク・セパレート装置

機能説明

・ローダ（製品供給）

フレーム収納リールに収納されているフレームをハンド(爪)に引っ掛け、フレームをピックアップします。

・２枚重ね検知

製品が２枚同時に入ってくることを判別します。

・レーザマーク

製品に品名及び、ロットNoを印字します。
スキャニングタイプのレーザマーカーを採用し、鮮明なマークを印字します。

・マーク検査

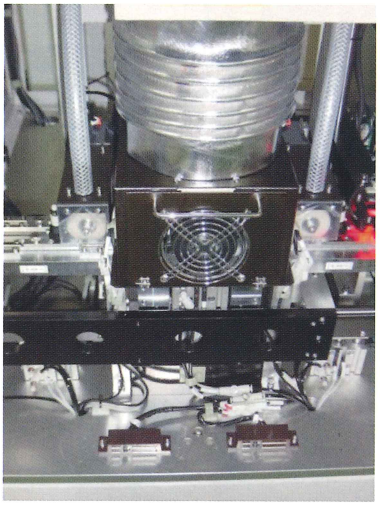
レーザで印字された文字を正しく印字されたか検査を行います。

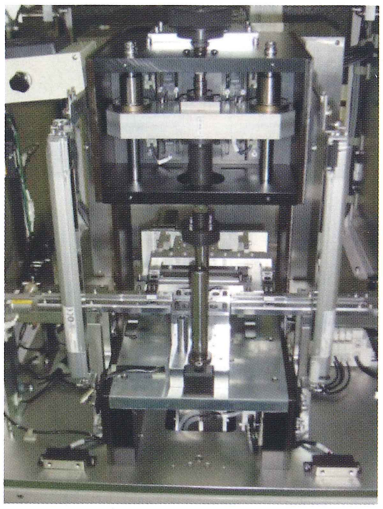
・フレーム送り確認

金型動作時に、フレーム搬送でトラブルが無いか確認します。

・金型セパレート

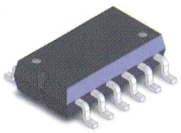
サーボプレスを用い、フレーム上の製品を切り離します。





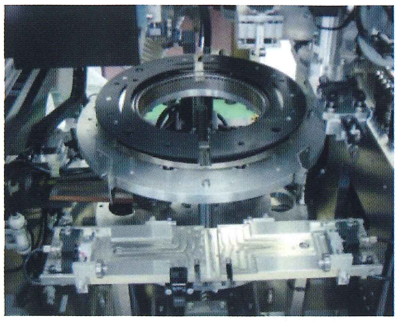




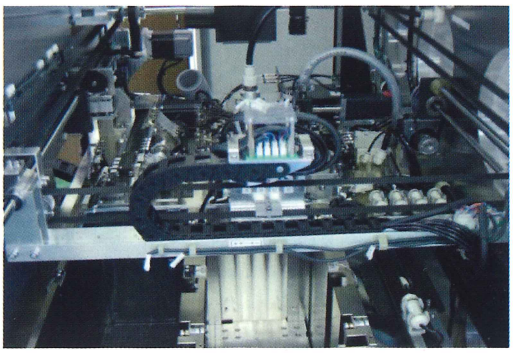


・営業品目　概要

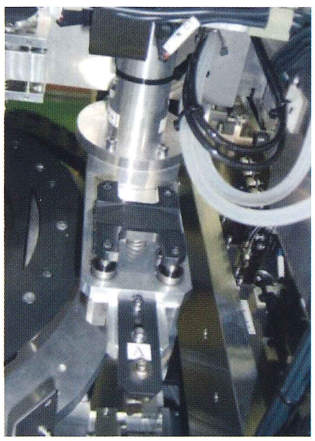
企画段階よりお客様のニーズに応じた装置を設計・製作致します。







Cリング～トレイ収納レーザマーク装置



機能説明

・供給ステージ
　ローダラックからリングを自動的に引き出しエキスパンド方式で、製品を吸着する機構を採用しています。

・供給アーム
　個別に製品を取り出し、アームの上下動作にサーボモータを採用しました。
品種毎に高さ等のデータを設定可能にした為、段取り換えが容易です。

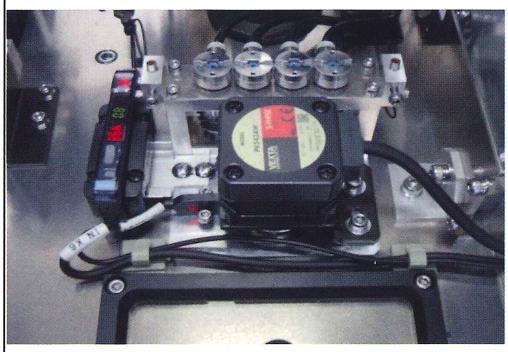
・反転アーム
　次工程のレーザマーク印字を行う為にマーク面を上向きに反転させます。

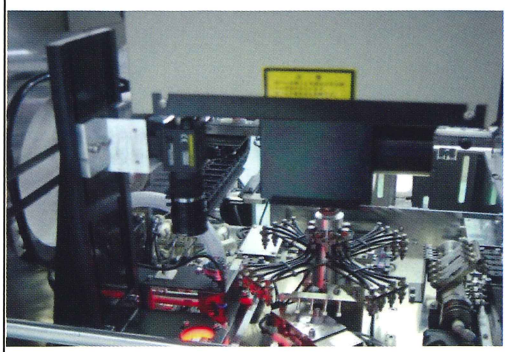
・レーザマーク
　位置決めチャックにより製品を固定し、レーザにより製品名及び、トレーサビリティを印字します。

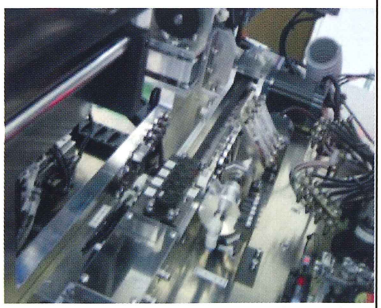
・マーク検査
　前工程のマーク印字の合否を判定します。

・回転ポケット
　次工程の製品向きにあわせる為に、パッケージをトレイに詰め、製品の向きを回転補正します。

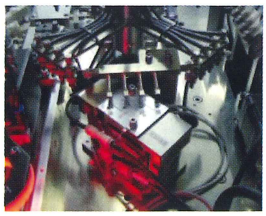
・トレイ収納
　ＸＹ軸４ハンドリング機構を採用し、マトリックストレイの収納位置を高精度に収納します。











・営業品目　概要

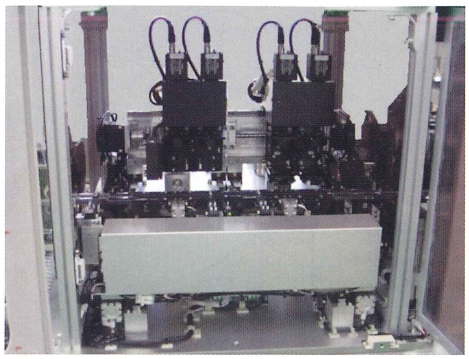
企画段階よりお客様のニーズに応じた装置を設計・製作致します。



リードカット装置



トレイ整列収納装置



外観検査装置



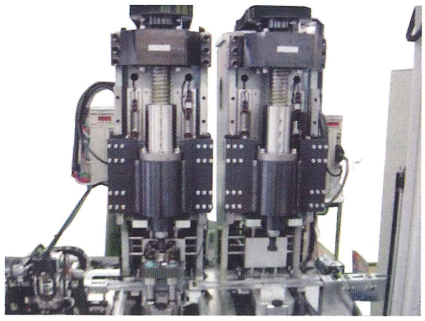
ゲートカットバリ取り



レーザバリ除去装置



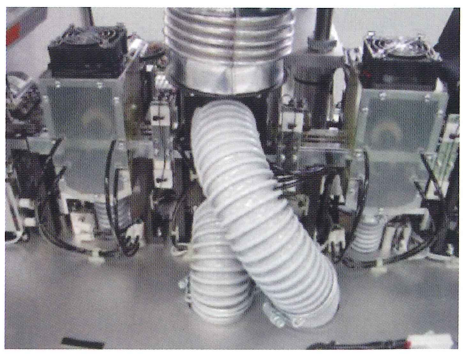
外観検査セパレート



ダブルヘッドサーボプレス装置



ウエハ搬送ロボット

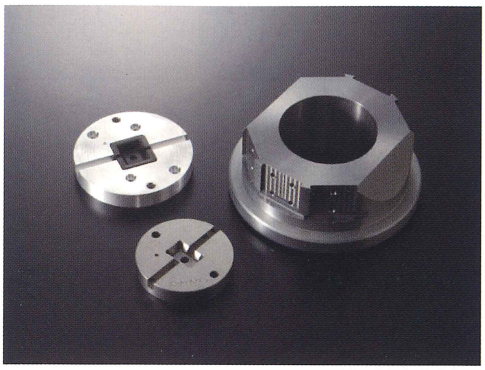


レーザバリ取り装置

・営業品目　概要

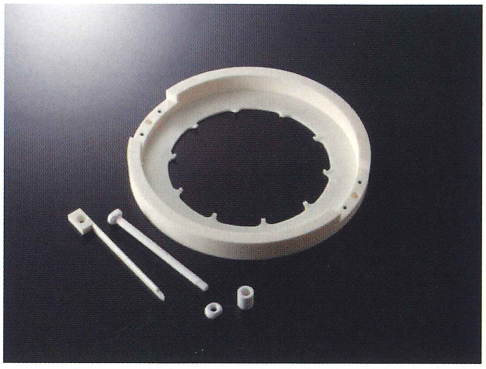
特殊材料や特殊処理など、さまざまな加工部品から高精度部品や微細部品など難易度の高い加工部品までお客様のニーズに対応した商品をご提供しております。

・半導体関連部品
・超硬部品
・セラミック部品
・特殊樹脂部品
・切断、成形金型部品
・モールド金型部品　切断、成形金型部品



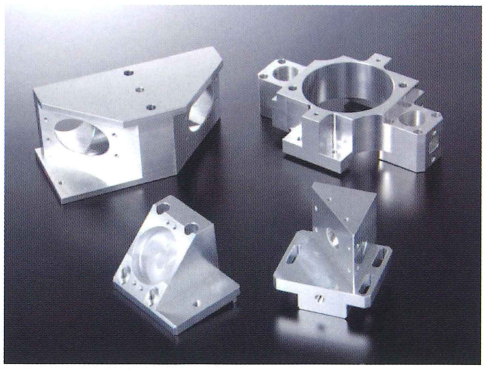
半導体テスティング用
位置決めポケット

材質：SUS304 ｾﾐﾄﾛﾝ Ti ﾎﾟﾘﾏｰ



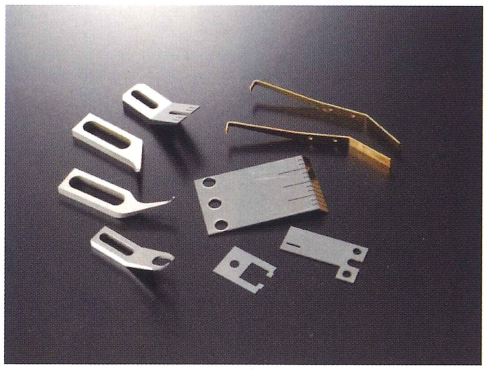
半導体前工程向セラミック部品

材質：ｱﾙﾐﾅｾﾗﾐｯｸ SiN ｼﾞﾙｺﾆｱ



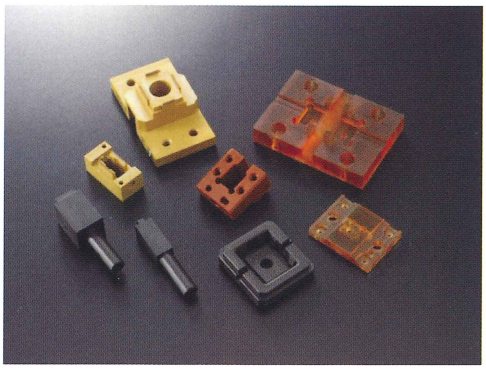
精密加工部品、光学系部品

材料：ｱﾙﾐ類



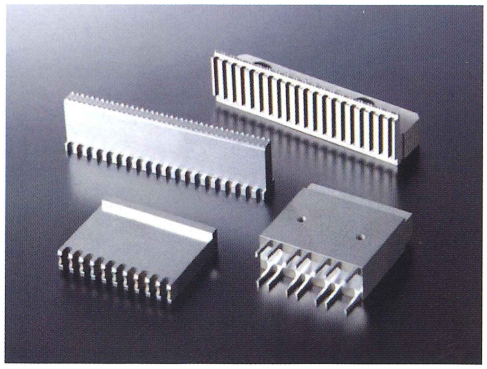
半導体組立用
リードフレームクランプ部品

材質：SKS-3　SUS304　SUS301



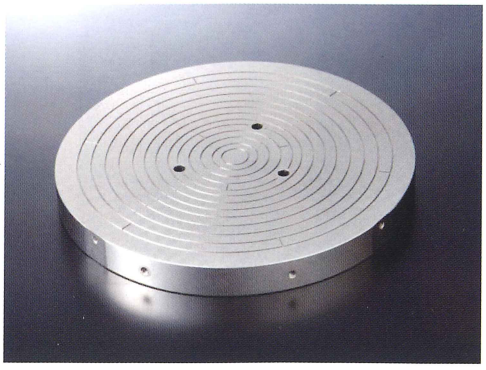
精密樹脂加工部品

材料：ｾﾐﾄﾛﾝ・ﾍﾞｽﾍﾟﾙ・PES
PEEK・ﾃﾌﾛﾝ・ﾀﾞｲﾌﾛﾝ



精密金型部品

材質：SKD-11　超硬　超微粒子超硬
ｾﾗﾐｯｸ

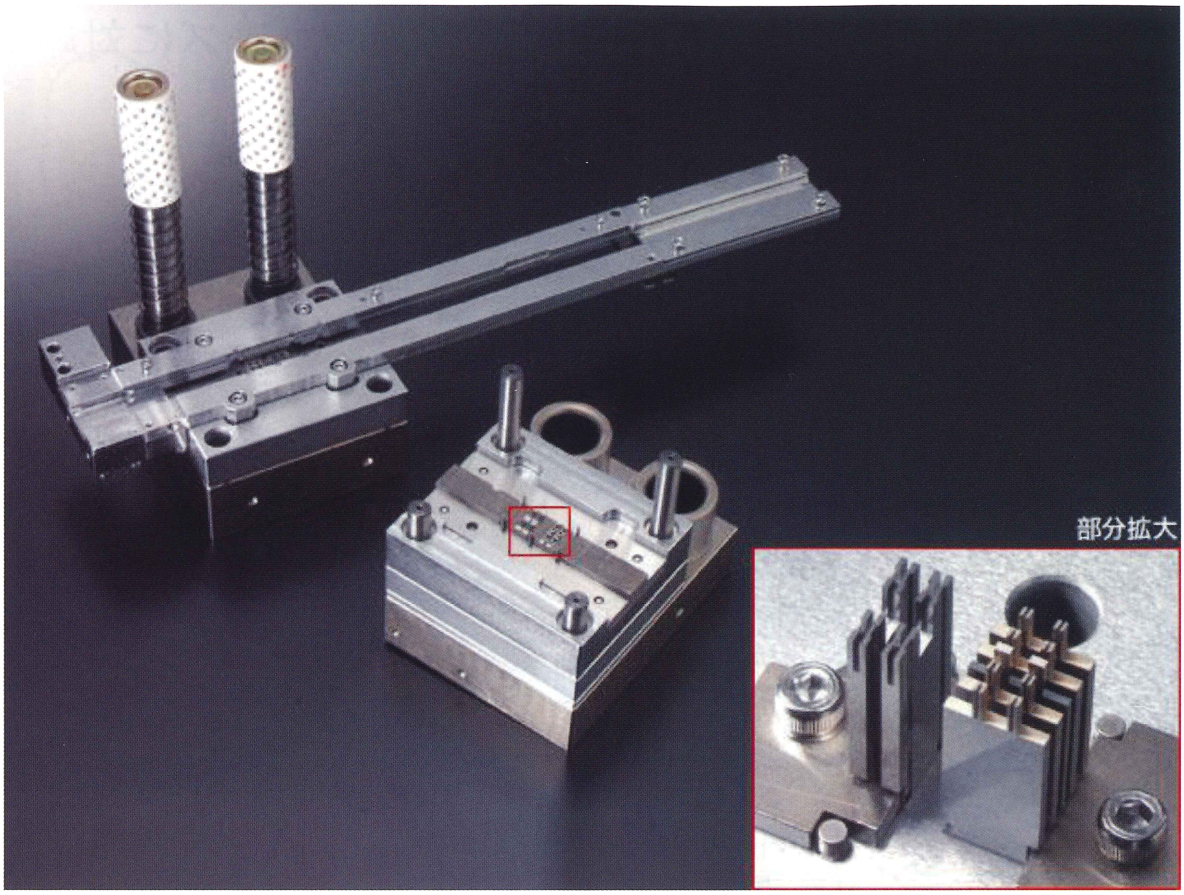


プローバー用チャック

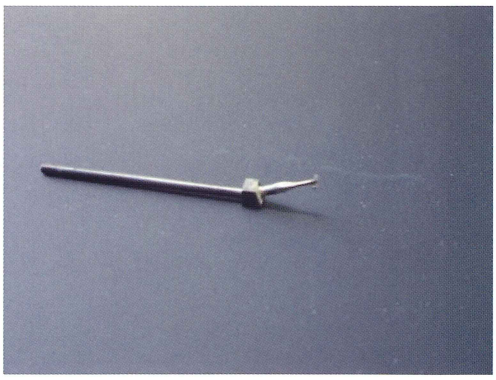
厚付金メッキ　10～20μ　平坦度 0.002 以内

・営業品目　概要

精密加工部品、精密金型部品、各種消耗部品



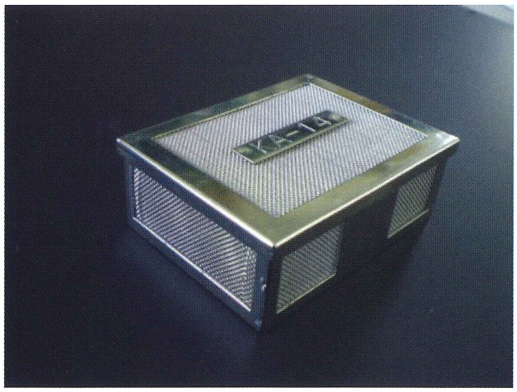
半導体製造装置に搭載される切断金型



半導体ウエハの吸着ノズル

材質:超硬

特徴:耐久性及び、耐摩耗性を考え
超硬を採用



薬品洗浄用網カゴ

材質:　SUS



半導体ウエハの吸着ステージ

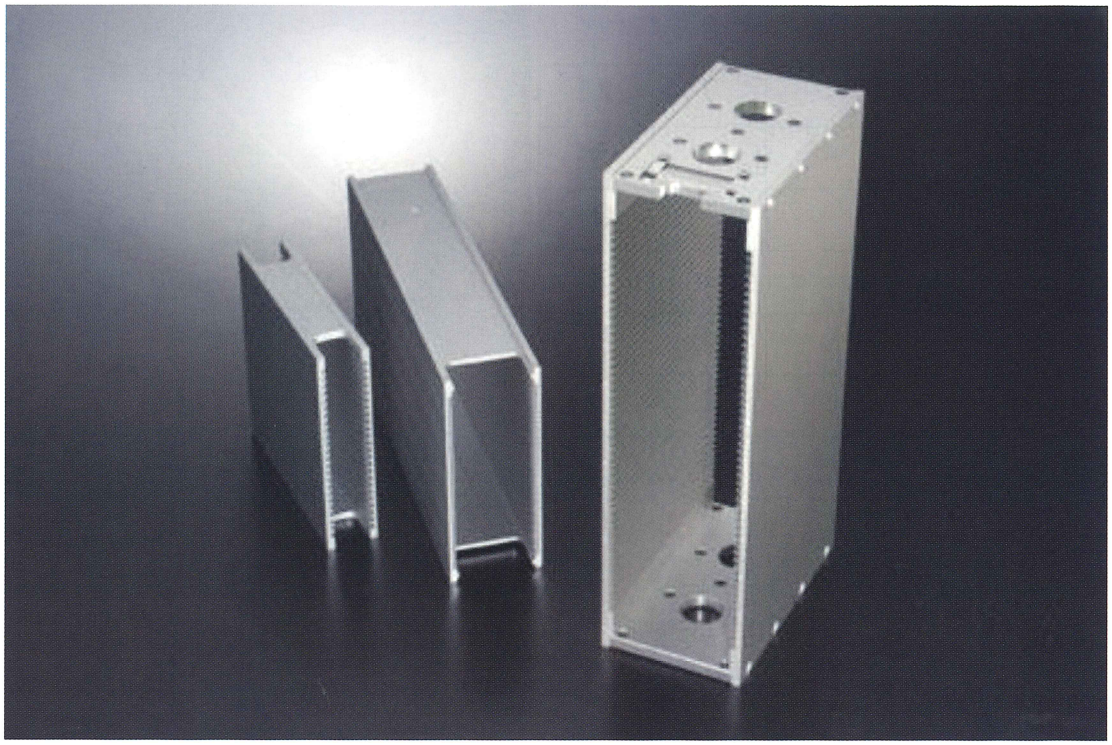
材質:SUS440C

特徴:0.1mm の小径穴加工
カメラ撮像の為に表面を鏡面仕上げ

・営業品目　概要

半導体製造用各種治具・工具
製造現場の作業性向上をサポートする製品を提供致します。

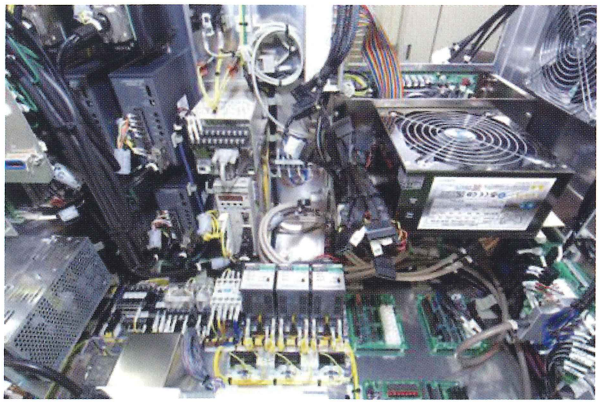
- 半導体組立作業用マガジンラック
- 選別作業用パレットマガジン
- 搬作業用キャリア
- ウエハカセット
- フープ用巻取りリール切断
- 基板用マガジンラック
- フープ不良抜取り工具
- 真空ピンセット
- 成形金型部品　切断、成形金型部品



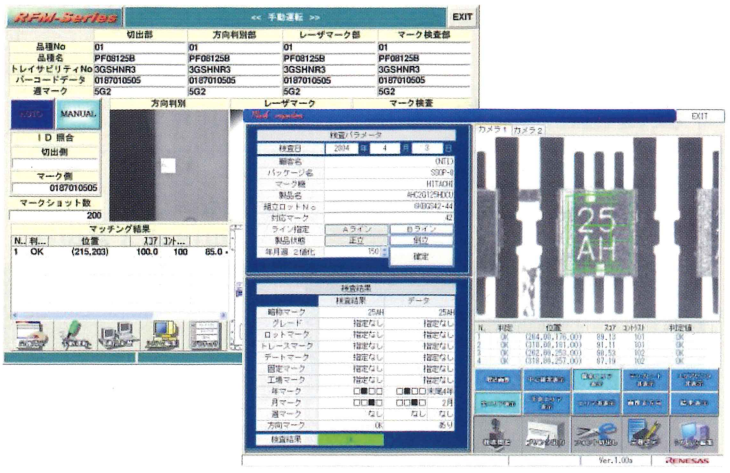
組立作業用マガジンラック（アルミ押出一体マガジン、オーダメイドマガジン）

制御ソフト／制御配線
より使いやすく、より確実に装置本来の性能を発揮するソフト開発を致します。

- 各種省力機械制御ソフト設計
- 外観、異音、各種検査装置の分析ソフト設計
- 省力機械データリンクシステム
- 各種省力機械電気設計製作
- LED照明
- テスティングソケット
- 操作ボックス・筐体製作
- 各種基板設計製作



操作ボックス・筐体製作



各種省力機械制御ソフト設計
パソコン制御／PLC 制御

・主な生産設備

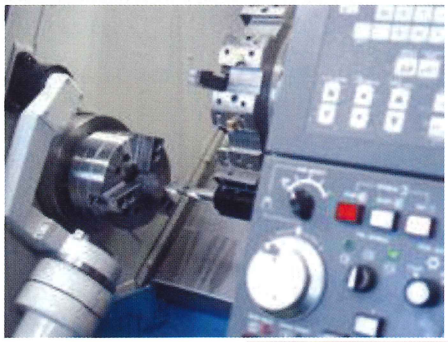
「マンマシン」（人間－機械系）の一方の中核をなす「機械」。
システムセイコーの実力の１つは、その充実度にあります。

	機種名	台数	
		本社	前橋
1	ワイヤー放電加工機	7	
2	NC 形彫り放電加工機	1	
3	ターニングセンタ	3	
4	立形マシニングセンタ	7	22
5	横形マシニングセンタ	2	5
6	5 軸マシニングセンタ		1
7	ミーリングセンタ	1	1
8	NC フライス盤	4	1
9	治具フライス盤	2	
10	CNC 旋盤	4	
11	旋盤	2	
12	平面研削盤	8	
13	成形研削盤	3	
14	精密円筒研削盤	2	
15	細穴放電加工機	1	
16	コンタマシン	1	2
17	ボール盤	4	6
18	タッピング盤	2	2
19	2.5 軸 CAD/CAM	2	2
20	三次元 CAD/CAM		2
21	三次元測定器	1	
22	測定顕微鏡	1	1
23	表面粗さ測定機	1	
24	高速丸鋸切断機		1

2019 年 3 月現在

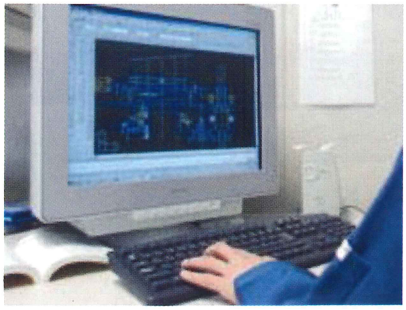














・会社概要

	本社工場	前橋工場	茨城営業所
名称			
所在地	〒370－3523 群馬県高崎市福島町 713－5	〒379－2147 群馬県前橋市亀里町 878	〒319－1116 茨城県那珂郡東海村 舟石川駅西1－4－13
TEL	027－373－2625	027－226－1211	029－283－5333
FAX	027－373－2645	027－226－1217	029－283－5588
URL	http://www.system-seiko.co.jp		
E-mail	eigyou@system-seiko.co.jp		ibaraki @system-seiko.co.jp

設立　平成2年5月2日

代表者　細野正己

資本金　1000万円

取引銀行　群馬銀行　みずほ銀行　常陽銀行







交通アクセス

JR高崎駅下車タクシーにて
約15分
JR井野駅下車タクシーにて
約5分
関越自動車道前橋ICより
高崎方面に約5分

JR高崎駅下車タクシーにて
約15分
関越自動車道高崎・玉村ICより
前橋方面に約１０分
関越自動車道前橋南ICより
高崎方面に約5分

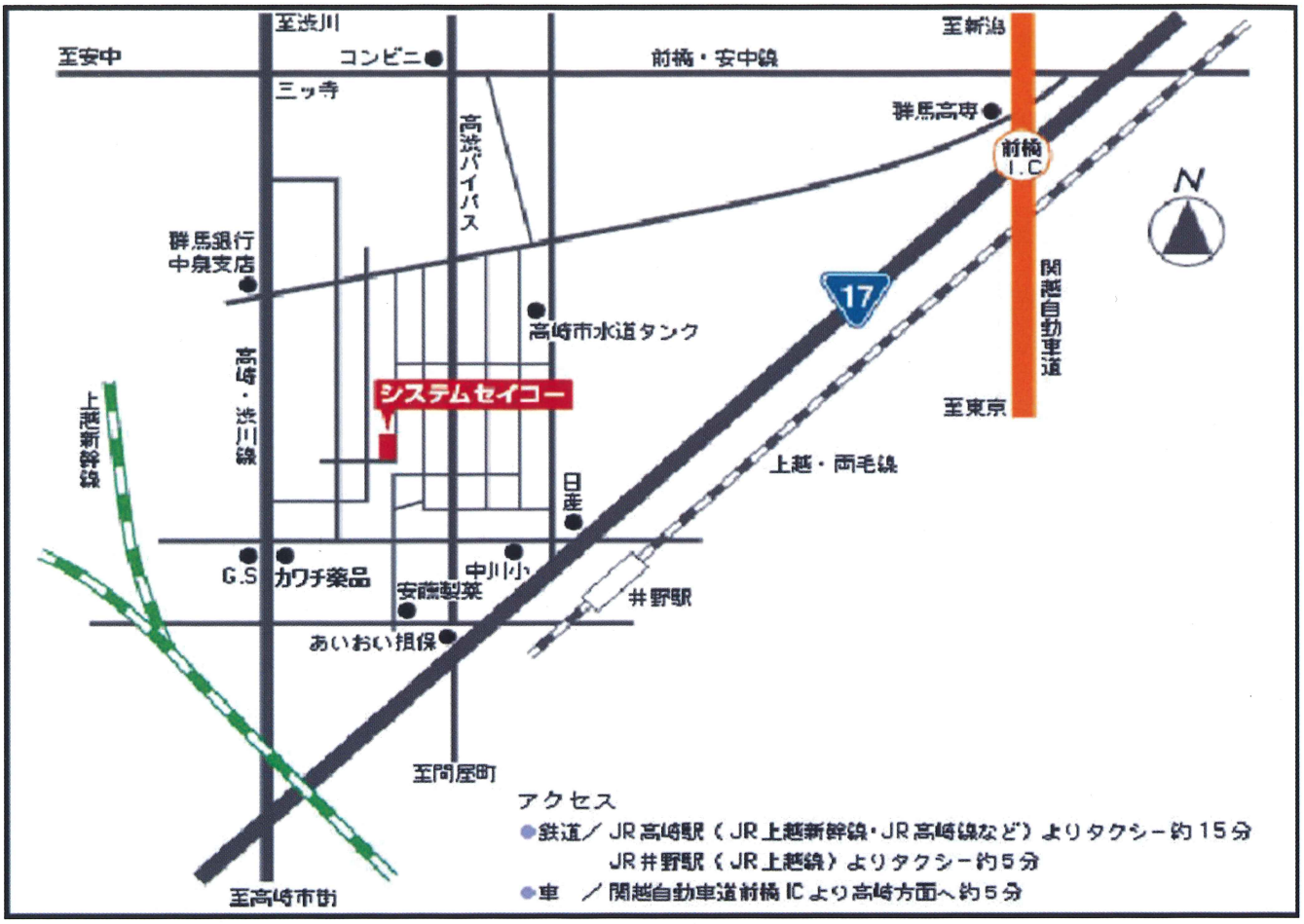
JR東海駅下車徒歩にて
約15分
常磐自動車道那珂ICより
東海村方面に約20分

事業内容

半導体製造装置　設計製作
各種省力機械　設計製作
（ソフトウエア開発販売）

精密金型・精密部品　設計製作
各種治工具　設計製作
（画像処理・装置制御）

案内ＭＡＰ


至渋川
至安中
コンビニ
前橋・安中線
三ッ寺
至新潟
群馬高専
前橋
I.C
高渋バイパス
N
群馬銀行
中泉支店
17
関越自動車道
高崎市水道タンク
高崎・渋川線
システムセイコー
至東京
上越新幹線
上越・両毛線
日産
G.S
カワチ薬品
中川小
安藤製菓
井野駅
あいおい損保
至問屋町
至高崎市街
アクセス
●鉄道／JR高崎駅（JR上越新幹線・JR高崎線など）よりタクシー約15分
JR井野駅（JR上越線）よりタクシー約5分
●車　／関越自動車道前橋ICより高崎方面へ約5分

拡大ＭＡＰ


至安中
前橋・安中線
至渋川
至前橋
三ッ寺
高渋バイパス
とりせん
小板橋歯科
食の駅
群馬火工
群馬銀行
中泉支店
G.S
パチンコ
コンビニ
中泉登烏組合
さまた
接骨院
高崎市水道タンク
ラリック
高崎・渋川線
システムセイコー
丸喜電子
藤田
デバイス
神田運送
G.S
17
日産
G.S
カワチ薬品
日立物流
SANYO
榛名酪連
中川小学校
安藤製菓
あいおい損保
上越線